

# CFB-609B 硬件设计手册

NB-IoT 系列版本：V0.1

CFB-609B\_硬件设计手册

日期：2022-03-16

深圳云程科技有限公司

[www.ccfrom.com](http://www.ccfrom.com)

## 文档更新历史

更新记录：

版本	日期	更改内容	备注
0.1	2022-03-16	初始版本	

## 目录

1 综述.....	4
2 模组介绍 .....	4
2.1. 主要性能.....	4
2.2. 功能框图.....	5
3 应用接口.....	6
3.1. 引脚分配.....	6
3.2. 引脚描述.....	7
3.4. 电源设计.....	8
3.5. 开机/关机 .....	9
3.6. 省电技术.....	10
3.7. 串口.....	11
3.8. 模数转换接口 .....	13
3.9.USIM 卡接口.....	13
3.10. PWM接口.....	14
4 天线接口 .....	14
4.1. 射频参考电路.....	15
4.2. NB-IoTRF 输出功率.....	17
4.3. 工作频率.....	17
4.4.天线设计关注点.....	17
4.5. 推荐 RF 焊接方式.....	20
5 电气性能和可靠性.....	21
5.1. 绝对最大值.....	21
5.2. 工作温度.....	21
5.3. 模块工作电流.....	21
6 机械尺寸.....	22
6.1. 模块机械尺寸 .....	22
6.2. 模块PCB尺寸 .....	23
7 存储、生产和包装.....	24
7.1. 存储.....	24
7.2. 生产焊接.....	25
7.3. 包装.....	26

# 1 综述

CFB-609B 是一款高集成度模块，支持 NB-IoT 标准通信，NB-IoT 支持 698-2180MHz 全频段，支持 Band 1、3、5、8、20 频段。支持 E-SIM 功能。它主要应用于低功耗的数据传输业务，符合 NB-IoT 无线电通信协议（3GPP Release-13/14/15）标准。

CFB-609B 模块可与众多终端设备进行连接，内嵌 TCP/UDP/CoAP/MQTT/DTLS/DTLS+ 等数据传输协议，支持 3GPP Rel13/14/15 及扩展的 AT 命令。支持基站定位。几乎能满足所有物联网方面的应用需求。例如：智能计量、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、智能家居、农业和环境监测等。

CFB-609B 支持二次开发，拥有 GPIO19 个，可以支持 SPIx1、UARTx3、I2Cx2、ADCx2、PWMx1 标准接口。

CFB-609B 采用 LCC 贴片封装，并具有 20mm × 16mm × 2.2mm 的超小尺寸。

CFB-609B 模块采用了省电技术，功耗在省电模式（PSM）下，约 1uA。

## 2 模组介绍

### 2.1. 主要性能

下表详细描述了 CFB-609B 模块的主要性能。

特性	说明
供电	VBAT 供电电压范围：2.1V-4.2V 典型供电电压：3.6V
省电	PSM 下最大耗流：1uA
频段	Band 1、3、5、8、20
发射功率	23dBm±2dB
温度范围	正常工作温度：-35°C ~ +75°C *1 扩展工作温度：-40°C ~ - +85°C *2
USIM 卡接口	支持 USIM 卡：1.8V/3V
天线接口特征阻抗	50 欧姆
串口	主串口：AT 命令传输或数据传输，波特率 115200bps， 升级串口：软件升级波特率 115200bps
物理特征	尺寸：长 20±0.2 mm，宽 16±0.2 mm，厚 2.2±0.2 mm 重量：1.6g
固件升级	调试串口

备注：

\*1 表示当前模块工作在此温度范围时，模块相关性能满足 3GPP 标准要求。

\*2 表示当前模块工作在此温度范围时，模块可以保持正常工作状态，具备短信、数据传输等功能，不会出现不可恢复的故障、射频频谱，网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数可能会超出 3GPP 标准，当温度返回正常工作范围时，模块各项指标仍符合 3GPP 标准。

## 2.2. 功能框图

下图为 CFB-609B 功能框图，阐述了其主要功能：

- 射频部分
- 电源管理
- 外围接口

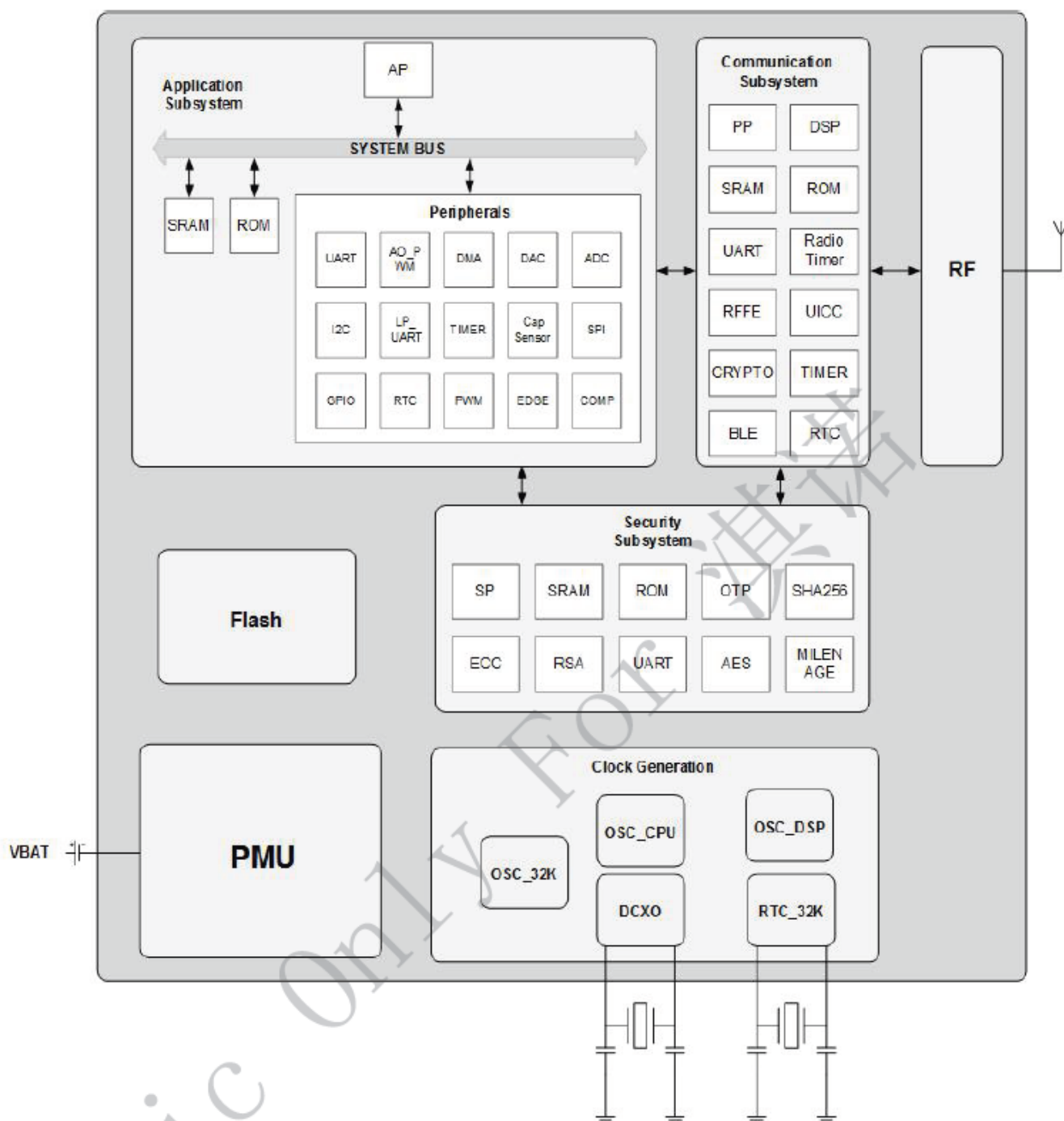


图 1：功能框图

## 3 应用接口

CFB-609B 模块共有 46 个引脚。下面详细阐述了模块各组接口的功能：

### 3.1. 引脚分配

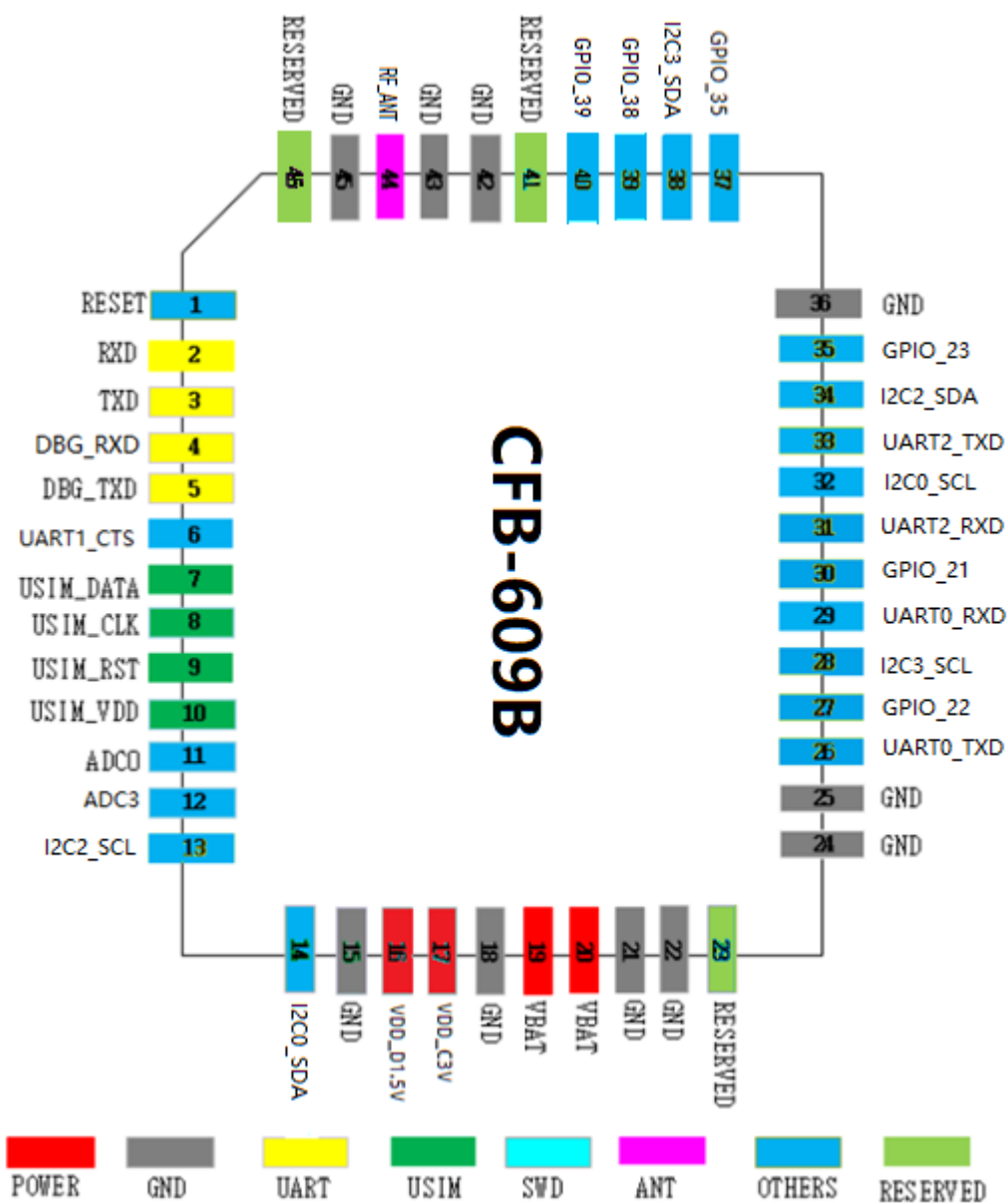


图 2 引脚功能图

### 3.2. 引脚描述

引脚名	引脚号	I/O 类型	描述	DC 特性	备注
VBAT	19, 20	PI	模块供电: VBAT=2.1V~4.2V	标准电压 3.6V 最大电压 4.2V 最小电压 2.1V	输入电源需能提供 500mA 电流
GND	15,18,21,22,24,25,36, 42,43,45	地			
RESET	1	DI	模块复位信号输入	最大低电平 0.6V	内部上拉, 低电平有效
RXD	2	DI	模块主数据接收	接口电压 3.0V	用于 NB-IoT AT 命令发
TXD	3	DO	模块主数据发送	接口电压 3.0V	送接收
GPIO	37,38,39,40	I/O	通用控制接口	接口电压 3.0V	不用可以悬空
DBG_RXD	4	DI	模块调试数据接收	接口电压 3.0V	用于 NB-IoT 调试及软件
DBG_TXD	5	DO	模块调试数据发送	接口电压 3.0V	升级, 不用可以悬空
RF_ANT	44	RF	NB-IoT+BT 天线接口	50 欧姆阻抗	
SIM_DATA	7	I/O	SIM 卡数据信号		
SIM_CLK	8	DO	SIM 卡时钟信号		
SIM_RST	9	DO	SIM 卡复位信号		
SIM_VCC	10	PO	SIM 卡 VCC 供电		
PWM1_OUT	14	I/O	PWM 信号输出		可做 GPIO23 使用, 不用 可以悬空
AIO0	11	AI	ADC 输入	电压输入范围 0V 到 1.4V	不用可以悬空
AIO3	12	AI	ADC/DAC 输入输出	电压输入范围 0V 到 1.4V	
UART1_RTS	13	I/O	UART1_RTS	接口电压 3.0V	配合 DBG 串口实现 4 线 串口模式,
UART1_CTS	6	I/O	UART1_RTS	接口电压 3.0V	
VDD_D1.5V	16	PI	VDD_D 组供电输出	电压 3.0V	用于 D 组 IO
VDD_C3V	17	PI	VDD_C 组供电输出	电压 3.0V	用于 C 组 IO
SPI_CLK	26	DO	SPI 接口时钟信号	3.0V 电压接口	可做 GPIO13 使用
SPI_CS	27	DO	SPI 接口片选信号	3.0V 电压接口	可做 GPIO15 使用
SPI_SI	28	DI	SPI 数据输入信号	3.0V 电压接口	可做 GPIO14 使用
SPI_SO	29	DO	SPI 数据输出信号	3.0V 电压接口	可做 GPIO16 使用
UART2_RXD	30	DI	UART2 数据接收	3.0V 电压接口	可做 GPIO10 使用
UART2_TXD	31	DO	UART2 数据发送	3.0V 电压接口	可做 GPIO11 使用
LUART_TXD	32	DO	LUART 数据发送	3.0V 电压接口	可做 GPIO19 使用
LUART_RXD	33	DI	LUART 数据接收	3.0V 电压接口	可做 GPIO20 使用
I2C_SCL	34	DO	I2C 接口时钟	3.0V 电压接口	可做 GPIO26 使用
I2C_SDA	35	DIO	I2C 接口数据	3.0V 电压接口	可做 GPIO27 使用
RESERVED	23,41,46				

### 3.4. 电源设计

#### 3.4.1. 引脚介绍

CFB-609B 有 2 个 VBAT 引脚用于连接外部电源。如下表格描述了模块的 VBAT 引脚和地引脚。

表 6: VBAT 引脚和地引脚

引脚名	引脚号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	19、20	模块供电电源	2.1	3.6	4.2	V
GND	15,18,21,22,24,25,36, 42,43,45	地				

#### 3.4.2. 供电参考电路

电源设计对模块的性能至关重要。电源 VBAT 电压输入范围为 2.1V~4.2V。电源设计需要考虑纹波 <1%，噪声 <3%，为保证 VBAT 电压不会跌落到 2.1 以下，在靠近模块 VBAT 引脚端建议并联一个低 ESR (ESR=0.7R) 的 100uF 电容，以及 100nF, 100pF, 22pF 滤波电容，建议在靠近模块 VBAT 引脚增加 TVS 管，提高模块对浪涌电压的承受能力。并且 VBAT 的 PCB 走线尽量短并且粗，为确保大功率发射时电流较大，VBAT 线宽度要大于 2mm。

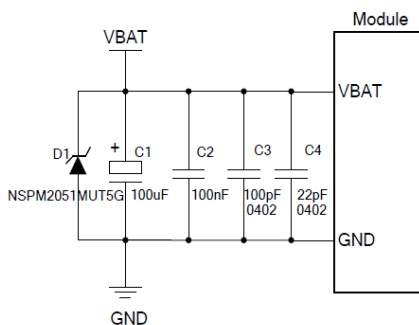


图 3: VBAT 输入端参考设计

### 3.5. 开机/关机

#### 3.5.1. 开机

模块 VBAT 上电后，外部控制 RESET 输入保持高电平，即可实现模块自动开机。

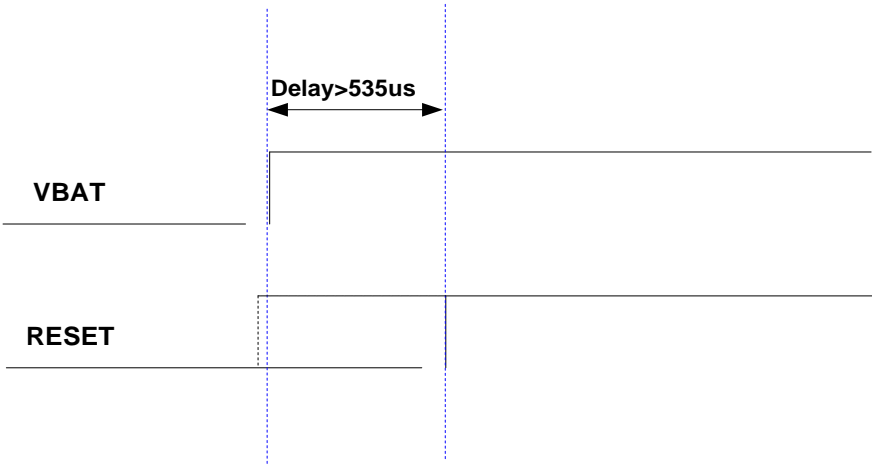


图 4：开机时序

#### 3.5.2. 关机

模块可以通过断开 VBAT 供电来实现关机。

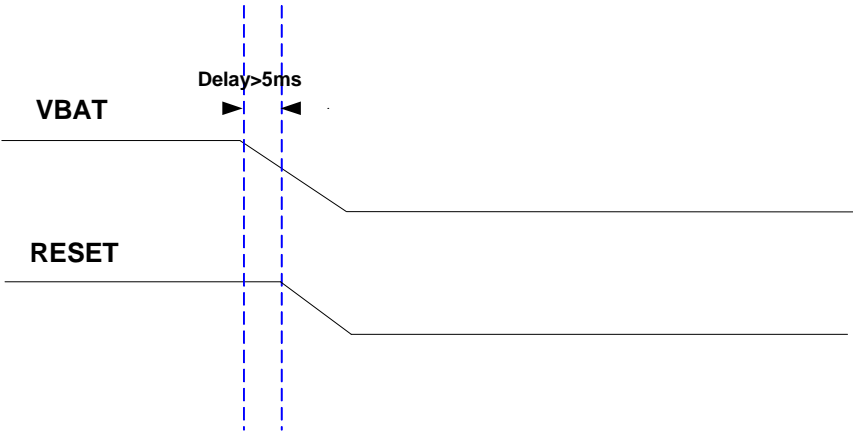


图 5：关机时序

#### 3.5.3. 复位模块

CFB-609B 通过拉低 RESET 管脚一定时间来实现模块复位。复位时间如下表所示。

表 7：复位引脚描述

引脚名称	引脚号	描述	复位时间
RESET	1	复位模块，低电平有效	>100ms

开机驱动和按键复位参考电路如下图所示。推荐使用开集驱动电路来控制 RESET 引脚。

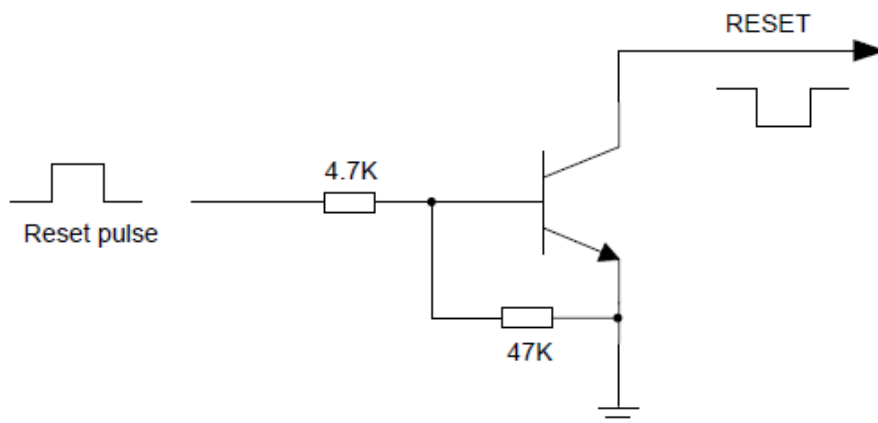


图 6：复位参考驱动电路

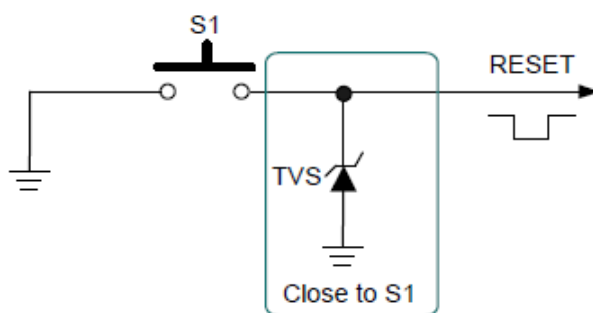


图 7：按键复位参考电路

由于 CFB-609B 模组升级过程中，需要复位操作切换模组内部运行状态，实现升级版本的加载，因此对于后期需要升级的产品，客户底板应该增加模块复位按键，设计按键时需要考虑按键的触感及回馈力度，同时增加电容防抖动，器件选型上需要考虑使用寿命。

### 3.6. 省电技术

模块在 PSM 下的最大耗流为 1uA。PSM 主要目的是降低模块功耗，延长电池的供电时间。下图显示了模块在不同模式下的功耗。

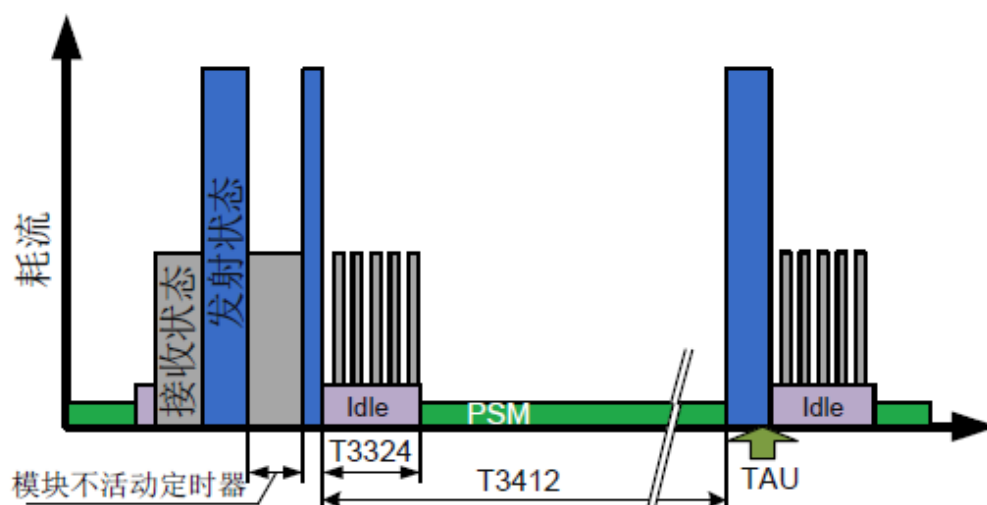


图 8：功耗参考图

模块进入 PSM 的过程如下：模块在与网络端建立连接或跟踪区更新（TAU）时，会在请求消息中申请进入 PSM，网络端在应答消息中配置 T3324 定时器数值返给模块，并启动定时器。当 T3324 定时器超时后，模块进入 PSM。模块在针对紧急业务进行连网或进行公共数据网络初始化时，不能申请进入 PSM。

当模块处于 PSM 模式时，将关闭大部分连网活动，包括停止搜寻小区消息、小区重选等。但是 T3412 定时器（与周期性 TAU 更新相关）仍然继续工作。

模块有两种方式退出 PSM，一种是 DTE 主动发送上行数据，模块退出 PSM；另一种是当 T3412 定时器超时后，TAU 启动，模块退出 PSM。

### 3.7. 串口

模块有两个串口是模块固定使用的：主串口和调试串口。模块作为 DCE (Data Communication Equipment)，并按照传统的 DCE-DTE (Data Terminal Equipment)方式连接。

另外两个串口是可以做二次开发使用，分别是 UART2，LUART。

表 8：串口引脚定义

接口	引脚名称	引脚号	描述	备注
调试串口	DBG_RXD	4	模块调试串口数据接收	接口电压 3.0V
	DBG_TXD	5	模块调试串口数据发送	接口电压 3.0V
主串口	RXD	2	模块主数据串口接收	接口电压 3.0V
	TXD	3	模块主数据串口发送	接口电压 3.0V
UART2	RXD	30	模块主数据串口接收	接口电压 3.0V
	TXD	31	模块主数据串口发送	接口电压 3.0V
LUART	RXD	32	模块主数据串口接收	接口电压 3.0V
	TXD	33	模块主数据串口发送	接口电压 3.0V

表 9：串口逻辑电平：

参数	最小值	最大值	单位
V <sub>IL</sub>	-0.1 × VDD_EXT	0.2 × VDD_EXT	V
V <sub>IH</sub>	0.7 × VDD_EXT	1.1 × VDD_EXT	V
V <sub>OL</sub>		0.4	V
V <sub>OH</sub>	2.4	VDD_EXT	V

#### 3.7.1. 串口

主串口可用于 AT 命令通信和数据传输，波特率为 115200bps。

调试串口用于模块调试，软件升级

下图显示了 DCE 和 DTE 之间的连接示意图。

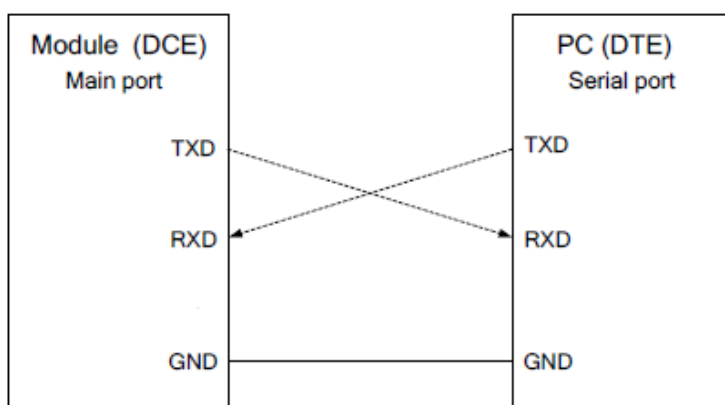


图 9：串口连接方式示意图

### 3.7.2.串口应用

3.3V 电平接口：3.3V 电平情况下的电平匹配电路参考设计如下。

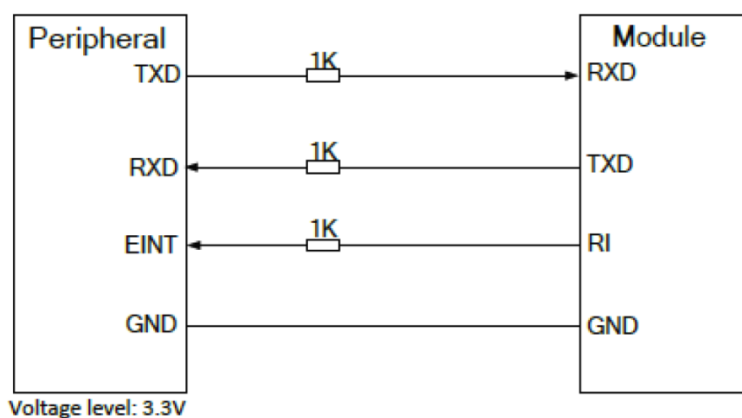


图 10：3.3V 电平转换电路

### 备注

当主机系统电平是 3.0V 或者 3.3V 时，为了降低串口功耗，强烈建议在模块和主机的串口连接上加入 1K 以上的电阻，用于降低串口电流。对于更高的电压系统之间的电平匹配，需要在模块和主机之间增加电平转换芯片。

5V 电平接口：模块和外设之间的电平匹配可以参考如下设计。其中 VCC\_MCU 是客户端的 I/O 电平电压，VDD\_EXT 是模块输出的 I/O 电平电压。

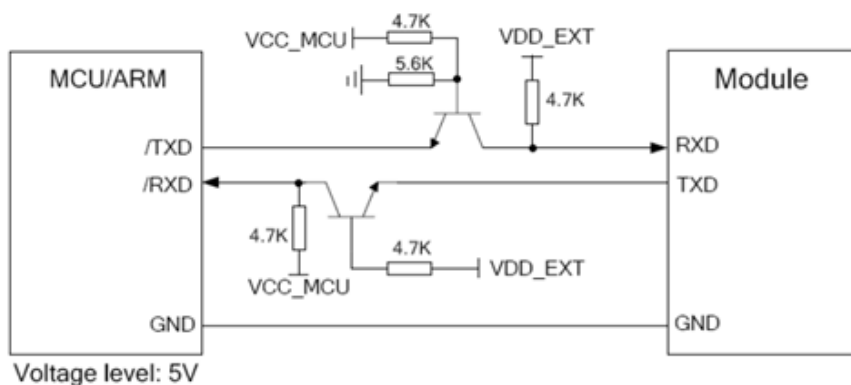


图 11: 5V 电平转换电路

RS232 标准接口：由于模块串口电平是 3.0V，当模块和 PC 通讯时需要加入 RS232 电平转换电路，下图是标准 RS-232 接口和模块之间的连接示意图。客户需要确保电平转换芯片连接到模块的 I/O 电压是 3.0V。

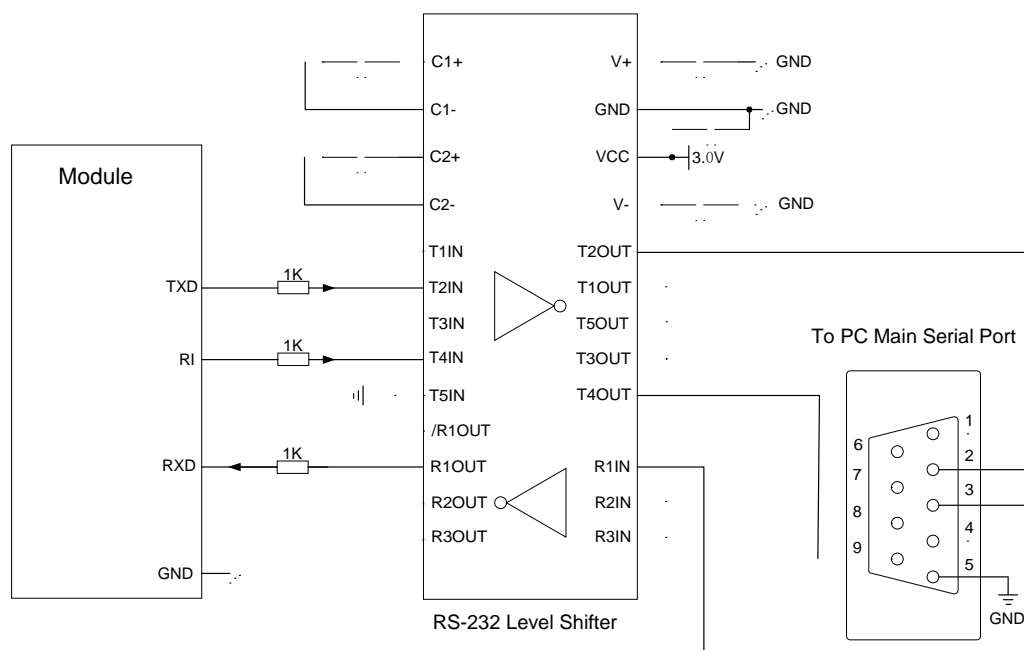


图 12：RS232 电平转换电路

请访问供应商网站选择合适的 RS-232 电平转换芯片，如 <http://www.maximintegrated.com> 和 <http://www.exar.com>。

### 3.8. 模数转换接口

模块提供了两路 12 位模数转换 ADC 接口，该 ADC 接口支持 0-1.4V 电压范围。

表 10：数模转换接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
ADC	11、12	模拟信号转换成数字信号

### 3.9. USIM 卡接口

模块包含一个外部 USIM 卡接口，支持模块访问 USIM 卡。该 USIM 卡接口支持 3GPP 规范的功能。外部 USIM 卡通过模块内部的电源供电，支持 1.8V/3.0V 供电的 SIM 卡。

表 11：外部 USIM 卡接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
USIM_VDD	10	外部 USIM 卡供电电源，电压精度：1.8V/3.0V±5%
USIM_CLK	8	外部 USIM 卡时钟线
USIM_DATA	7	外部 USIM 卡数据线
USIM_RST	9	外部 USIM 卡复位线

下图是 6-pin 外部 USIM 卡座的参考设计。

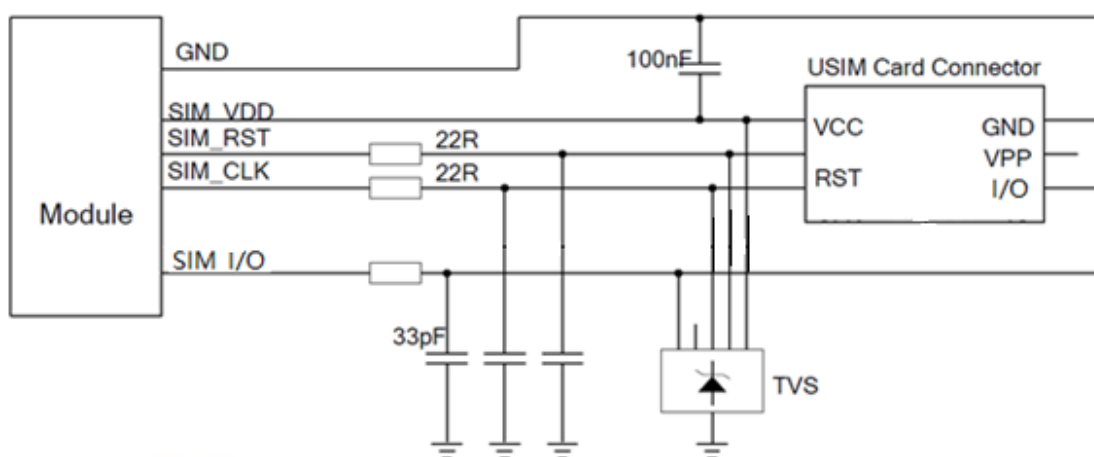


图 13：6-PIN 外部 USIM 卡参考电路

关于外部 USIM 卡座的选择，请访问网址<http://www.pt-joint.com> 和<http://www.molex.com>。

在外部 USIM 卡接口的电路设计中，为确保外部 USIM 卡的良好性能并防止外部 USIM 卡被损坏，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- ☐ 外部 USIM 卡座靠近模块摆放，尽量保证外部 USIM 卡信号线布线长度不超过 100mm。
- ☐ 外部 USIM 卡信号线布线远离 RF 走线和 VBAT 电源线。
- ☐ 外部 USIM 卡座的地与模块的 USIM\_GND 布线要短而粗。为保证相同的电势，需确保布线宽度不小于 0.5mm。USIM\_VDD 的去耦电容不超过 1uF，且电容应靠近外部 USIM 卡座摆放。
- ☐ 为了防止 USIM\_CLK 信号与 USIM\_DATA 信号相互串扰，两者布线不能太靠近，并且在两条走线之间需增加地屏蔽。此外，USIM\_RST 信号也需要地保护。
- ☐ 为确保良好的 ESD 防护性能，建议在外外部 USIM 卡的引脚增加 TVS 管。选择的 TVS 管寄生电容应不大于 50pF，可以访问<http://www.onsemi.com> 来选择合适的 TVS 器件。ESD 保护器件尽量靠近外部 USIM 卡座摆放，外部 USIM 卡信号走线应先从外部 USIM 卡座连到 ESD 保护器件再从 ESD 保护器件连到模块。在模块和外部 USIM 卡之间需要串联 22 欧姆的电阻用以抑制杂散 EMI，增强 ESD 防护。外部 USIM 卡的外围器件应尽量靠近外部 USIM 卡座摆放。
- 在 USIM\_DATA, USIM\_VDD, USIM\_CLK 和 USIM\_RST 线上并联 33pF 电容用于滤除射频干扰。

### 3.10. PWM 接口

模块提供了两路 PWM 接口输出。

表 12：数模转换接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
PWM1_OU	14	PWM 信号输出
GPIO36	38	PWM 信号输出，支持在 PSM 状态下保持 PWM 输出

## 4 天线接口

引脚 44 是模块的 NB-IoT+BT 部分 RF 天线接口。引脚 46 是 GNSS 的 RF 天线接口，两个天线接口阻抗均为  $50\Omega$ 。

表 13: RF\_ANT 引脚、定义

引脚名称	引脚号	描述
GND	42	地
GND	43	地
RF_ANT	44	RF 天线接口
GND	45	地

#### 4.1. 射频参考电路

对于天线接口的外围电路设计，为了能够更好地调节射频性能，建议预留  $\pi$  型匹配电路， $\pi$  型匹配电路元件应尽量靠近天线放置。天线连接参考电路如下图所示。其中 C1, C2 缺省不贴，只贴 0 欧姆 R1 电阻。

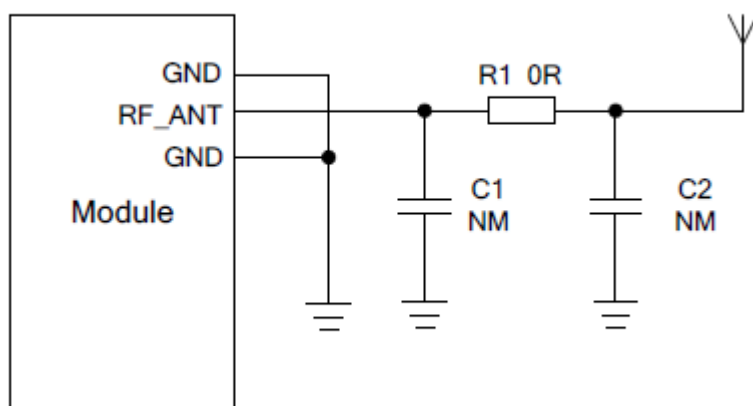


图 14: 射频参考电路

CFB-609B 提供了一个 RF 焊盘接口来连接外部天线。从该焊盘到天线连接器间射频走线的特性阻抗要控制在  $50\Omega$  左右，且走线尽可能短，转弯处运用  $45^\circ$  角走线或者圆弧处理以减小寄生电容。CFB-609B 模块 RF 接口两侧都有接地焊盘，以获取更好的接地性能。

为了最小化 RF 走线或者 RF 电缆上的损耗，必须谨慎设计。尽量控制插入损耗小于  $1\text{dB}$ 。建议客户 PCB 部分发给云程科技检查，产品样机出来到云程进行射频指标测试。

#### 4.1.1. 射频信号线 Layout 参考指导

对于用户 PCB 而言，所有的射频信号线的特性阻抗应控制在  $50\Omega$ 。一般情况下，射频信号线的阻抗由材料的介电常数、走线宽度 (W)、对地间隙 (S)、以及参考地平面的高度 (H) 决定。PCB 特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则，下面几幅图展示了阻抗线控制为  $50\Omega$  时微带线以及共面波导的结构设计。

##### ■ 共面波导完整结构

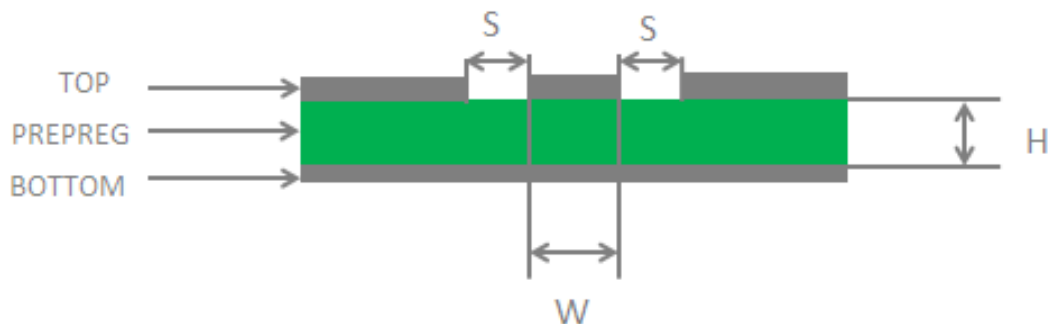


图 15：两层 PCB 板共面波导结构

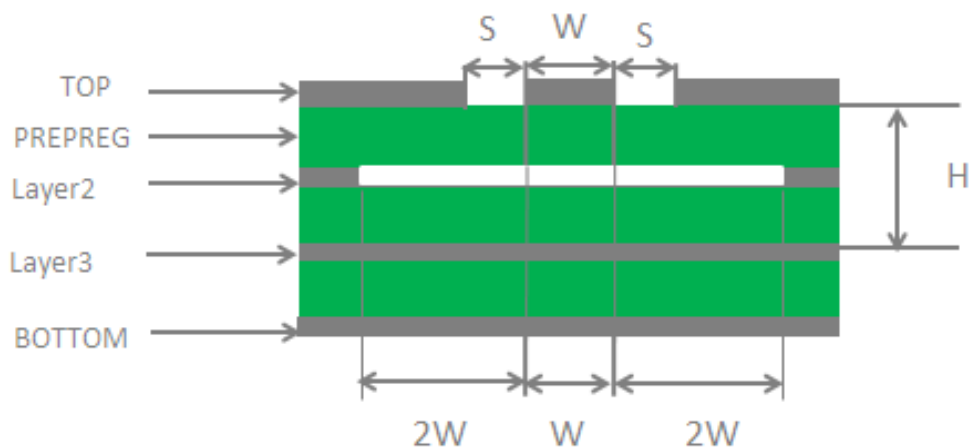


图 16：四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第三层)

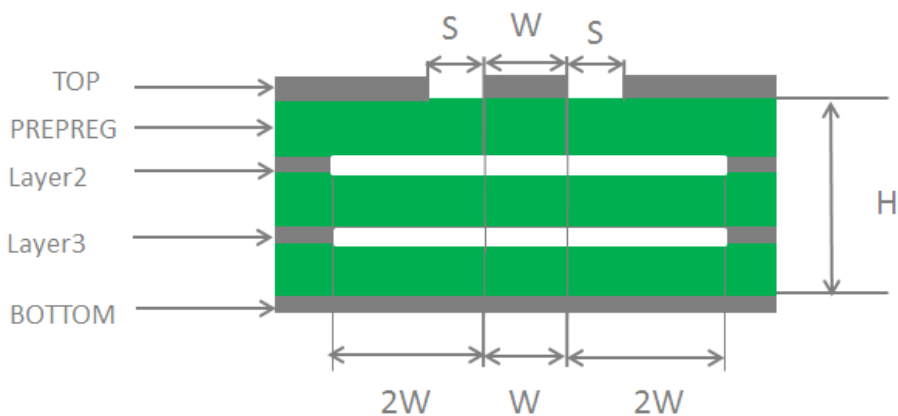


图 17：四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第四层)

在射频天线接口的电路设计中，为了确保射频信号的良好性能与可靠性，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的  $50\Omega$  阻抗控制。（阻抗可以让 PCB 厂家进行控制）
- 与射频引脚相邻的 GND 引脚不做热焊盘。
- 射频引脚到 RF 连接器之间的距离应尽量短；同时避免直角走线，要走弧形。能不拐弯的尽量不要拐弯。
- 连接器件封装建立时要注意，信号脚离地要保持一定距离。连接器镀金要好，防止有氧化问题。
- 射频信号线参考的地平面应完整；在信号线和参考地周边增加一定量的地孔可以帮助提升射频性能；地孔和信号线之间的距离应至少为 2 倍线宽 ( $2*W$ )。

## 4.2. NB-IoTRF 输出功率

表 14：RF 传导功率（上行 QPSK 和 BPSK 调制）

频率	最大值	最小值
Band 8	23dBm $\pm$ 2dB	<-40dBm
Band 5	23dBm $\pm$ 2dB	<-40dBm
Band 1	23dBm $\pm$ 2dB	<-40dBm
Band 3	23dBm $\pm$ 2dB	<-40dBm
Band 20	23dBm $\pm$ 2dB	<-40dBm
备注		

该设计符合 3GPP Rel-13/14 中的 NB-IoT 协议。

## 4.3. 工作频率

表 16：模块工作频率

频率	接收频率	发射频率
Band 5	865~894MHz	824~849MHz
Band 8	925~960MHz	880~915MHz
Band 1	2110~2170MHz	1920~1980MHz
Band 3	1805-1880MHz	1710-1785MHz
Band 20	791-821MHz	832MHz-862MHz

## 4.4. 天线设计关注点

1. 明确客户重点及硬件布局约束条件，客户重点包括：成本，尺寸布局，电气性能，以客户关注重点展开天线设计及选型方案
2. 终端产品外壳不能使用全金属材料封闭，最低也要满足天线辐射处金属开窗要求；
3. 天线布局要满足尽量远离射频器件，电源，金属屏蔽盖器件的原则；

4. PCB类的单极子微带天线，天线走线下方的地必须清空，用金属实现的单极子天线，可进行局部折叠以充分利用三维空间节省总体体积；

5. PIFA也较常用，设计形式可依托PCB，金属弹片，弹片+支架等不同形式实现，具体选择方式取决于产品空间布局及关注重点；

NB 终端产品应用场景及形态多样，天线实现方式也多样，本文所列相关几款天线设计参考不能完全包含所有场景，仅适合部分应用场景，针对具体应用场景的设计及选择应紧密结合产品 ID 及应用进行选择。

#### 4.4.1 终端天线规格参考

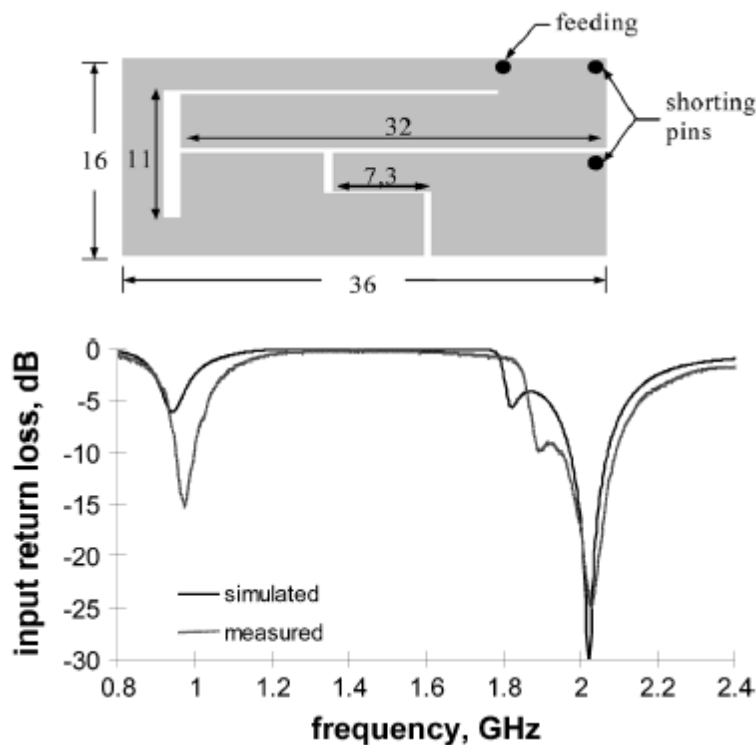
终端天线参考规格

项目	低频段	高频段+BLE	
频段	703-960MHz	1710-2200MHz	
驻波比	<3	<2	
峰值增益 dBi	1.5+/-0.5	2.0+/-0.5	
效率	30%-50%	50%-70%	
辐射方向	全向	全向	
阻抗	50	50	
极化方式	线极化	线极化	

#### PIFA 天线

原理：PIFA天线来源于倒F型天线，增大辐射电阻和提高辐射效率而采用顶部加载的技术，将顶部的辐射线用辐射平面替代，从而形成平面辐射单元，同时，将接地线和馈电线用具有一定宽度的金属片取代可以增大分布电容和减小分布电感，从而增大天线带宽。这样就形成了PIFA天线。

样例尺寸：下图所示的可支持双频的设计参考，开缝 PIFA 天线实现双频支持。



上图所示双频 PIFA 天线对应的 S 参数情况。

#### PCB 天线

原理：PCB天线即是在PCB上走线实现辐射功能的天线，可区分为普通PCB和柔性PCB。普通PCB即常规的以FR4为基材的普通印制电路板，硬度相对较高，也可使用其他基材如AD300C或RF30之类的板材做天线基板，只是针对终端类产品天线，单面或双面覆铜的FR4板更受青睐，其典型DK值为4.4。FPC即Flexible Printed Antenna，柔性电路板，是使用挠性基材制作的印制电路板。其重量比普通PCB轻，厚度薄，占体积小。

样例尺寸：75mm\*25mm\*0.8mm(FPC天线)

样例视图：



## 外置胶棒天线

原理：顾名思义，即天线不在内部或依托终端的PCB等而存在，天线外置于终端。外置天线是一大类，实现方式多种。

样例尺寸：168\*18\*13mm,Φ13mm(宽频带LTE天线)

样例视图：如图 6 所示，天线 SMA 转接处可折叠



以上这些天线客户可以根据产品外形使用情况来决定设计

#### 4.5. 推荐 RF 焊接方式

如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的，请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法，尤其是地要焊接充分。请按照下图中正确的焊接方式进行操作，以避免因焊接不良引起线损增大。

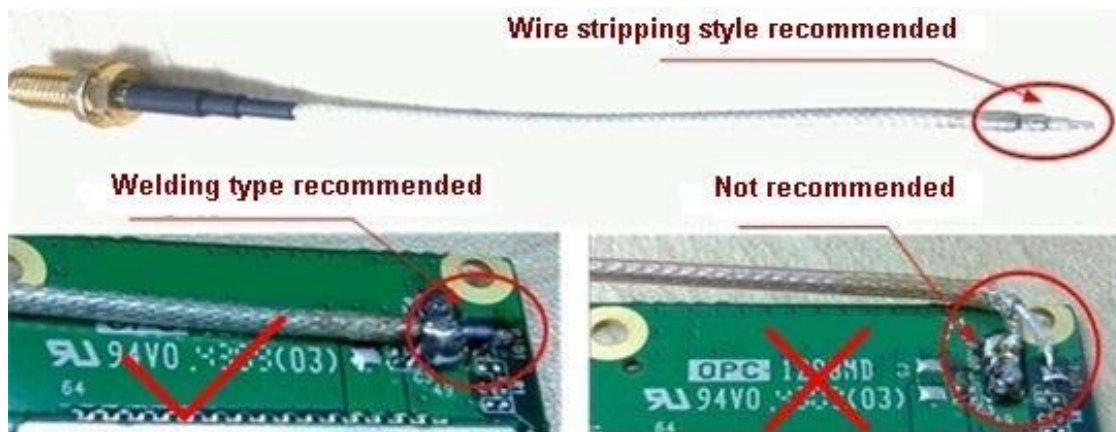


图 21：天线连接器焊接形式

## 5 电气性能和可靠性

### 5.1. 绝对最大值

下表所示是模块数字和模拟引脚的电源供电电压电流最大耐受值。

表 18：绝对最大值

参数	最小值	最大值	单位
VBAT	-0.3	+4.25	V
电源供电电流	0	0.3	A
数字引脚处电压	-0.3	+3.3	V
模拟引脚处电压	-0.3	+4.25	V
关机模式下数字/模拟引脚处电压	-0.25	+0.25	V

### 5.2. 工作温度

下表所示为模块工作温度范围。

表 19：工作温度范围

参数	最小	典型	最大	单位
正常工作温度范围 <sup>1)</sup>	-30	+25	+75	°C
扩展温度范围 <sup>2)</sup>	-40		+85	°C

备注：

- <sup>1)</sup> 表示当模块工作在此温度范围时，模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- <sup>2)</sup> 表示当模块工作在此温度范围时，模块仍能保持正常工作状态，具备短信、数据传输等功能，不会出现不可恢复的故障；射频频谱、网络基本不受影响，仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

### 5.3. 模块工作电流

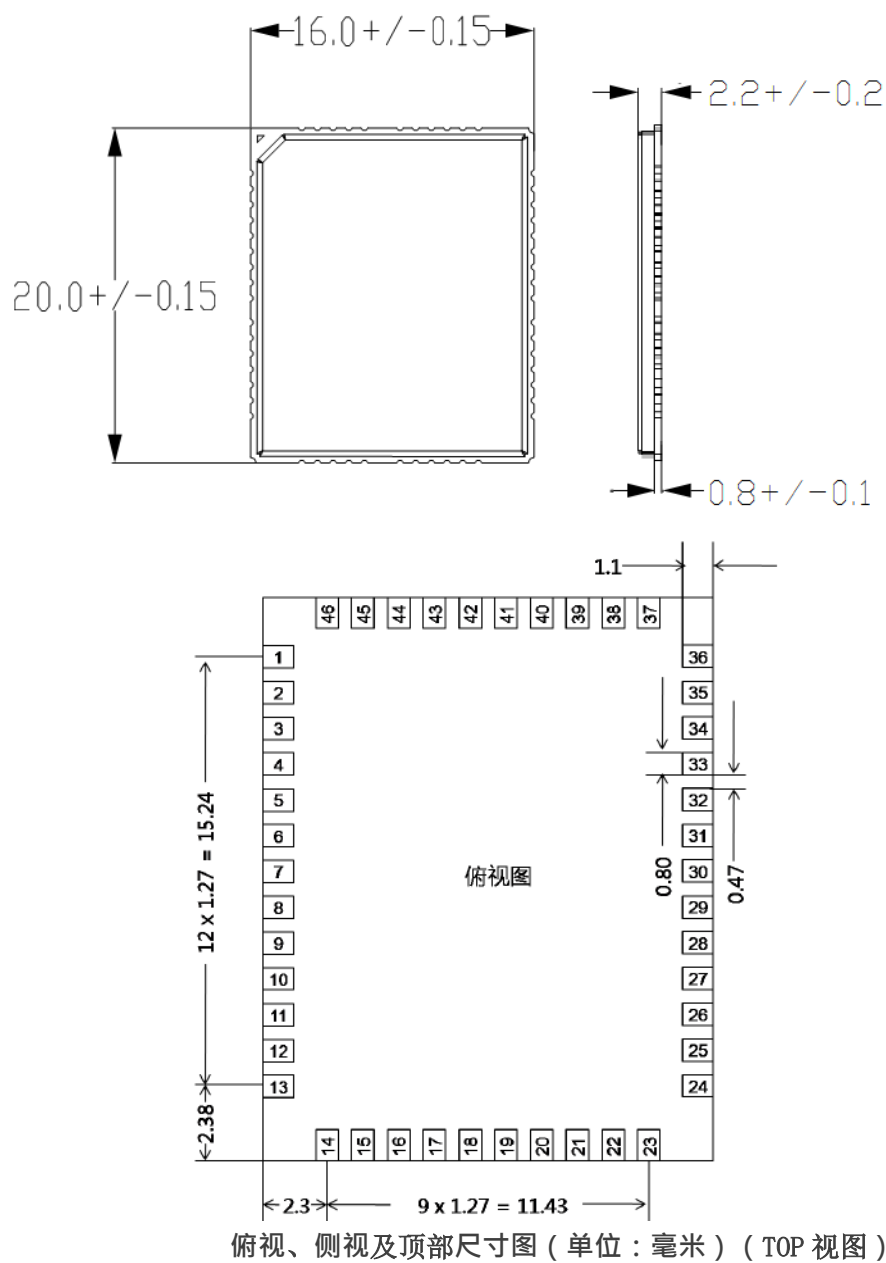
模块工作电流值如下表所示。3.6V 供电下测试

表 20：模块耗流

参数	模式	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ivbat	PSM	睡眠状态			1	uA
	Idle	空闲状态		2		mA
	Active	射频发射状态 (23dBm)		220		mA
		射频接收状态		17		mA

## 6 机械尺寸

### 6.1. 模块机械尺寸



## 6.2. 模块 PCB 尺寸

每个焊点尺寸为宽 0.80mm、长 2.0mm、焊点间距为 1.3mm

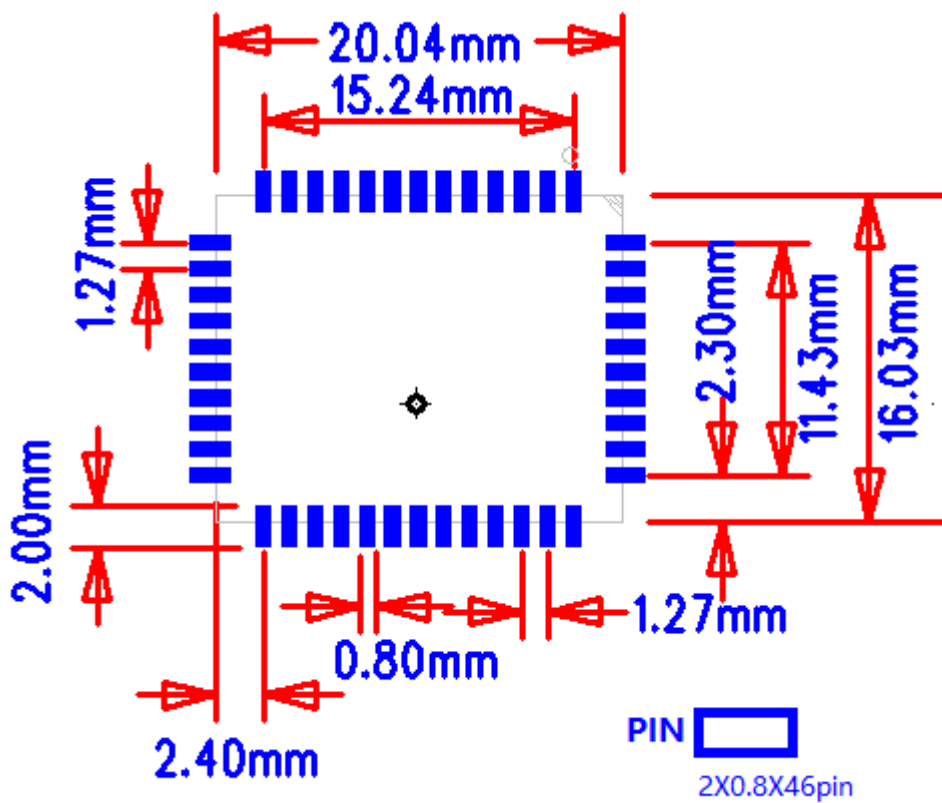


图 23：推荐 PCB 封装尺寸图（单位：毫米）（TOP 视图）

## 备注

1. 为保证模块能够正常安装，PCB 板上模块和其他元器件之间至少保持 3mm 距离。
2. 所有的保留引脚不能连接到地。
3. 所有尺寸单位都是毫米。

## 7 存储、生产和包装

### 7.1. 存储

CFB-609B 以真空密封带的形式出货。模块的存储需遵循如下条件：

1. 环境温度低于 40 摄氏度，空气湿度小于 90%（RH）的情况下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
2. 当真空密封袋打开后，若满足以下条件，模块可直接进行回流焊或其它高温流程：
  - ☐ 模块存储空气湿度小于 10%。
  - ☐ 模块环境温度低于 30 摄氏度，空气湿度小于 60%，工厂在 72 小时以内完成贴片。
3. 若模块处于如下条件，需要在贴片前进行烘烤：
  - ☐ 当环境温度为 23 摄氏度（允许上下 5 摄氏度的波动）时，湿度指示卡显示湿度大于 10%。
  - ☐ 当真空密封袋打开后，模块环境温度低于 30 摄氏度，空气湿度小于 60%，但工厂未能在 72 小时以内完成贴片。
  - ☐ 当真空密封袋打开后，模块存储空气湿度大于 10%。
4. 如果模块需要烘烤，请在 125 摄氏度下（允许上下 5 摄氏度的波动）烘烤 8 小时，烘烤累计时间小于 96 小时。

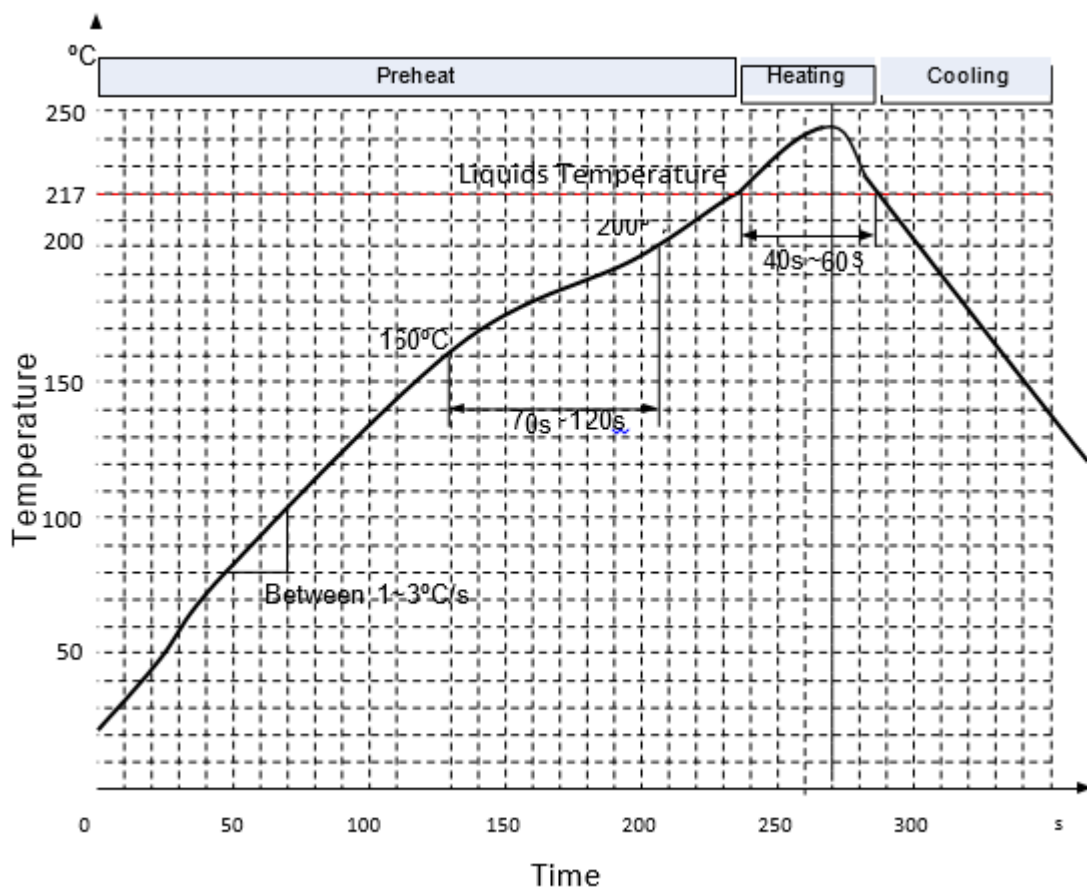
### 备注

模块的包装无法承受高温烘烤。因此在模块烘烤之前，请移除模块包装。如果只需要短时间的烘烤，请参考 *IPC/JEDECJ-STD-033* 规范。客户在使用模块时，请参照 *IPC-SM-782A* 规范

## 7.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上，印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量，CFB-609B 模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.18mm 左右。详细信息请参考文档[1]。

推荐的回流焊温度为 235~245°C，最高不能超过 260°C。为避免模块因反复受热而损坏，建议客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的回流焊曲线温度图如下所示：



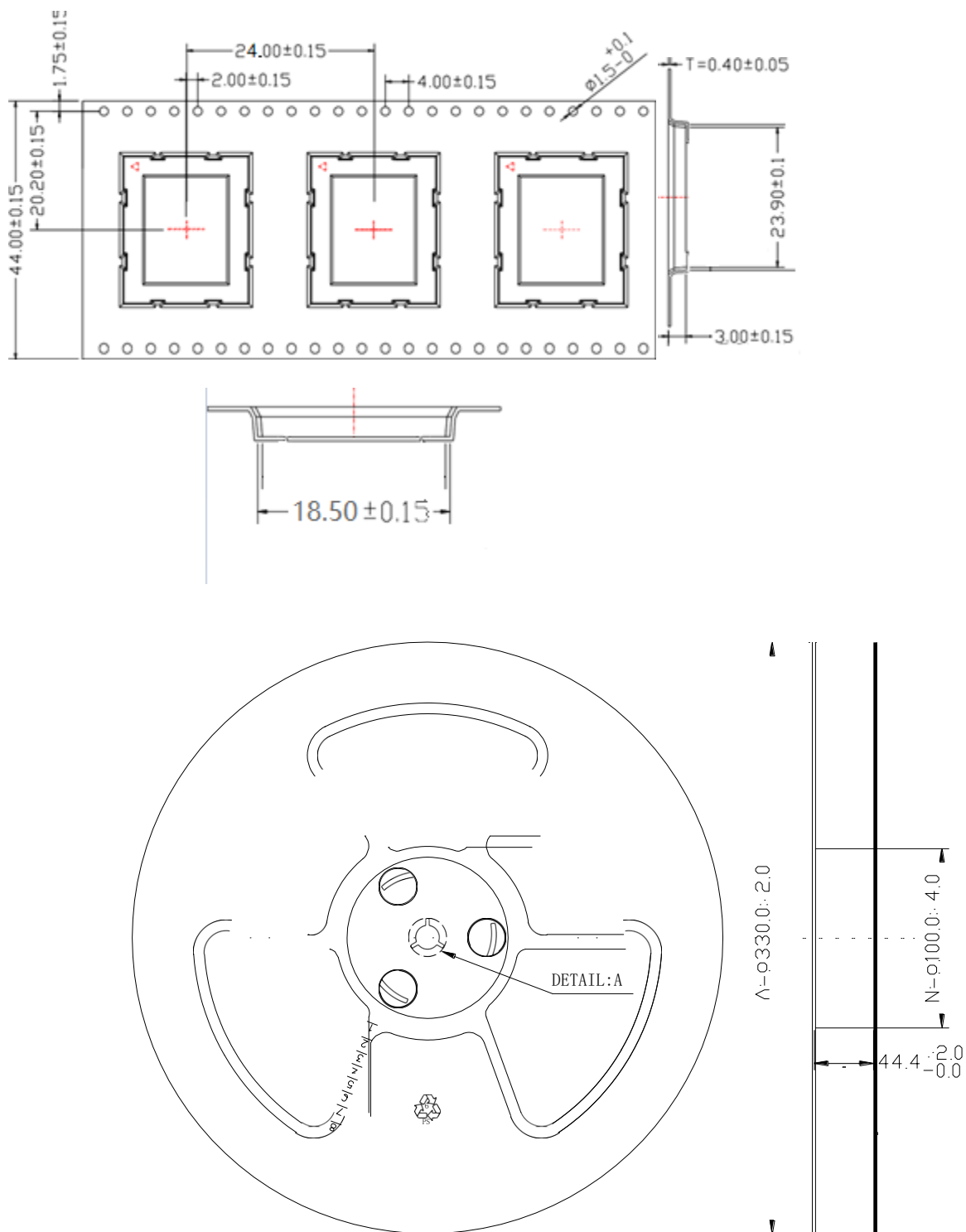
回流焊温度曲线

### 备注

在生产焊接或者其他可能直接接触云程通信模块的过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精，异丙醇，丙酮，三氯乙烯等）擦拭模块标签。

### 7.3. 包装

CFB-609B 模块采用卷带包装，并用真空密封袋将其封装，直到模块准备焊接时才可以打开包装。每个卷带包含 700 个 CFB-609B 模块，卷盘直径为 330 毫米。具体规格如下：



卷盘尺寸 (单位: 毫米)

深圳云程科技有限公司终为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨，如需任何帮助，请随时联系公司人员，联系方式如下：

深圳云程科技有限公司

深圳市福田区车公庙安徽大厦创展中心 10 楼 1018,1005 室

电话：+86 755 88358892

邮箱：[support@ccfrom.com](mailto:support@ccfrom.com)

深圳云程科技有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范，参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。在未声明前，深圳云程科技有限公司有权对该文档规范进行更新。